

Presented by 기업 분석 1조

한미반도체

2026

REPORT HANMI



목차

CONTENTS

01

산업 분석

02

기업 분석

03

투자포인트

04

리스크



01 산업 분석

한미반도체

글로벌 점유율 71%의 확산, 한미반도체 TC 본더

1) TC본더 장치 산업 개요

TC본더는 열과 압력을 이용해 칩을 수직으로 쌓아 올리는 핵심 장비이다. 이 장비는 열과 압력을 동시에 가하여 미세한 범프를 통해 전기적 연결을 형성하는 방식으로 작동하며, 기존의 단순한 접합 방식보다 더 높은 정밀도와 안정성을 확보할 수 있다. 특히 칩 간 간격이 매우 좁은 고집적 반도체에서 효과적으로 사용되며, **고성능 메모리인 HBM**과 같은 제품 생산에 필수적인 공정 장비로 자리 잡고 있다. 최근 인공지능(AI)의 발전으로 고성능 반도체(HBM) 수요가 증가하면서 TC본더의 중요성도 함께 커지고 있다.

TC본더 산업은 나노 단위의 열, 압축 제어가 필요한 고난도 기술을 필요로 하며 **AI 반도체(HBM) 수요**에 성적이 직접 연결되는 동반 성장 산업이라는 특징을 가진다. 또한 기술 해자(비용)가 깊어 선두 기업이 시장을 독식하며 고객사 맞춤형 장비 공급으로 이익률이 매우 높은 고부가가치 산업이라고 할 수 있다.

2) TC본더 산업 전망

2025년 3분기 누적 기준 **TC본더** 시장의 총 매출 규모는 약 3억 4800만 달러(한화 약 5100억) 수준으로 추산되며, 이 중 한미반도체가 약 2억 4770만 달러(한화 약 3660억)를 벌어들이며 시장을 주도하고 있다.

TC본더 산업은 앞으로도 **AI 슈퍼사이클과 HBM 고단화 흐름**에 힘입어 2030년까지 매년 13%씩 성장할 것으로 보인다. 특히 HBM4 본격 양산과 향후 하이브리드 본딩으로의 기술 진화, 그리고 낸드(반도체) 적층 공장으로의 기술 확산이 맞물리며 **반도체 후공정 장비 시장**의 핵심 성장축으로 자리매김할 전망이다.

주요 사업 분야



TC본더 장치, 마이크로 쏘

핵심 공급 기업



SK하이닉스, 마이크론, TSMC(협력), 글로벌 OSAT 기업들

01 산업 분석

한미반도체

글로벌 점유율 71%의 확산, 한미반도체 TC 본더

3) TC본더 시장 동향

TC본더 산업은 선두 기업이 시장을 독식하는 **독과점 구조**를 형성하고 있다.

한미반도체는 2025년 전 세계 **HBM용 TC본더 시장에서 71.2%**라는 높은 숫자로 점유율 1위를 달성했으며 2위는 삼성전자 계열 반도체장비업체인 세메스로, 13.1%를 차지하였다. 이러한 수치를 통해 TC본더 시장에서 한국 기업들이, 특히 한미반도체가 압도적인 위상을 차지하고 있다고 볼 수 있다.

마찬가지로 국내 점유율 또한 한미반도체는 SK하이닉스의 HBM 제조 공정에 표준처럼 사용되고 있어(하이닉스 내에서의 점유율 90%이상), 사실상 독점적 지위를 노린다고 할 수 있다. 전체 국내 **TC본더 시장 규모** 에서 한미반도체는 매출액과 수주 잔고 기준으로 70%이상의 지배력을 유지하고 있는 것으로 평가된다.

4) TC본더 시장 구조 핵심요약

1. 독보적 1강 체제
 - 한미반도체가 글로벌 점유율 71.2%로 시장을 압도하며 기술 표준을 주도하고 있음.
2. 전략적 전담 공급
 - 한미는 SK하이닉스, 세메스는 삼성전자로 이어지는 고객사별 전담 공급 구조가 뚜렷함.
3. 높은 기술 장벽
 - 장비 수출(합격률) 검증이 까다로워 선점 기업이 시장 이익을 독식하는 특성이 강함.

최근 산업 동향



TC본더 글로벌 시장 구조

HBM용 TC본더 시장 점유율 단위: %
2025년 12월 기준. 괄호 안은 3분기 누적 매출액



TC본더 시장 점유율



TC 본더 시장 성장 전망

02 기업 분석

한미반도체

글로벌 점유율 71%의 확산, 한미반도체 TC 본더

1) 기업 개요

한미반도체는 1980년 12월 24일에 ㉠한미금형이라는 이름으로 경기도 부천에 설립된 반도체 제조용 장비 전문 기업이다. 1996년 ㉠한미와 ㉠한성전자를 흡수 합병하고 상호를 ㉠한미로 변경하였다. 2002년에 다시 상호를 ㉠한미반도체로 변경하고 2005년 코스피 시장에 상장하였다. 1980년부터 **반도체 제조용 장비**를 개발 및 출시해 왔으며, 자체 기술을 적용하여 주물, 설계, 제작, 조립, 검사와 테스트까지의 수직통합 제조(Vertical Integration Manufacture) 시스템을 구축하여 글로벌 주요 AI 반도체 기업에 최첨단 장비를 공급해 오고 있다.

항목	내용
기업명 [㉠]	한미반도체 [㉠]
설립일 [㉠]	1980년 12월 24일 [㉠]
상장 [㉠]	코스피 042700 (2005년) [㉠]
대표이사 [㉠]	곽동신 [㉠]
본사 [㉠]	인천광역시 서구 [㉠]
주요 사업 [㉠]	반도체 어드밴스드 패키징 장비 생산 [㉠]

2) 주요 제품

① HBM TC(Thermal Compression) BONDER - 압도적 점유율의 주력 장비

당사의 주력 장비로 글로벌 HBM TC(Thermal Compression) 본더는 메모리칩에 정밀한 열과 압력을 가해 12단, 16단과 같은 고적층 HBM을 생산하는 핵심 장비이다. AI 서버와 데이터센터 투자 확대에 따라 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 급증하고 있으며 메모리 칩의 적층도가 고단화 될수록 TC 본더의 중요성은 더욱 커지고 있다. 최근 메모리 업계는 하이브리드 본더가 기술적 난제로 개발이 지연됨에 따라 20단 이상의 HBM 적층 시 보다 넓은 HBM칩을 적층할 수 있는 신장비의 필요성이 부각되고 있다. 이에 따라 Wide Die 본딩이 가능한 새로운 TC 본딩 공정의 중요성이 더욱 부각되고 있으며, 따라서 당사는 차세대 HBM 구조 변화에 선제적으로 대응하기 위해 'WIDE TC 본더' 출시를 앞두고 있다. 아울러 HBM 생산용과 시스템 반도체 적층용 하이브리드 본더도 병행 개발 증으로 향후 미래 수요에 체계적으로 대비하고 있다.

주요 제품 사진



TC 본더



micro SAW

02 기업 분석

한미반도체

글로벌 점유율 71%의 확신, 한미반도체 TC 본더

2) 주요 제품

② MVSP

micro SAW & VISION PLACEMENT(MSVP)는 반도체 패키지의 절단→세척→건조→2D/3D 비전 검사→선별→적재까지의 공정을 일괄 처리하는 반도체 제조공정의 필수 장비이다. 높은 안정성과 처리 속도를 바탕으로 2000년대 중반 이후 세계 시장점유율 1위를 유지하고 있는 당사의 핵심 장비이며 최근 전동 반도체 수요의 점진적 회복의 영향으로 수요가 증가하고 있다.

③ 6-SIDE INSPECTION

6-SIDE INSPECTION 장비는 TC 본딩 전후공정에서 HBM 수율을 관리하는 필수 검사 장비이다. TC 본더로 적층하기 전 개별 다이의 6면을 정밀 검사하고, 적층 완료 후 최종 HBM 칩의 외관 및 접합 상태를 검사하여 불량률을 최소화한다. HBM 생산량 증가와 고적층화 추세에 따라 검사 공정의 중요성이 높아지는 가운데, 이 장비는 HBM 수율 향상과 생산성, 검사 정밀도를 크게 향상시키며 향후 당사 매출 성장에 기여할 것으로 기대된다.

④ MVSP와 6-SIDE INSPECTION의 관계

MSVP는 반도체 칩을 자르고, 씻고, 검사하고, 분류하는 여러 단계가 합쳐진 복합 장비이다.

이 장비 안에서 '검사' 단계를 담당하는 핵심 모듈이 바로 6-SIDE INSPECTION이다.

작동순서

1. Micro SAW (절단): 웨이퍼를 칩 단위로 자른다.
2. Cleaning (세척): 절단 시 생긴 찌꺼기를 씻어낸다.
3. 6-SIDE INSPECTION (검사) : Saw Multi-Handler(로봇 팔)가 칩을 집어 올리고 칩을 공중에서 이동시키는 동안 상·하·좌·우·전·후 6개 면을 카메라로 순식간에 촬영한다.
4. Placement (분류): 검사 결과 "합격" 판정을 받은 칩만 트레이에 담는다.

주요 제품 사진



TC 본더



micro SAW

02 기업 분석

한미반도체

글로벌 점유율 71%의 확산, 한미반도체 TC 본더

3) 매출 구성

① 최근 3년 매출액

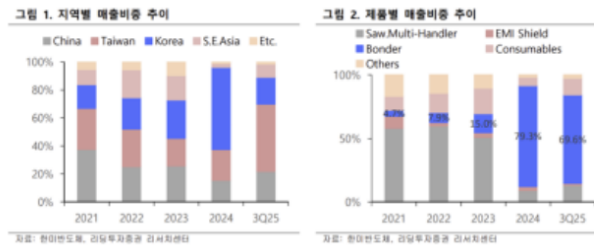
	2025.01.01 ~ 2025.12.31	2024.01.01 ~ 2024.12.31	2023.01.01 ~ 2023.12.31
매출액	576,685	558,917	159,009
영업이익	251,390	255,392	34,571
법인세차감전순이익	278,383	198,374	345,280
당기순이익	214,008	152,614	267,168
· 지배기업지분순이익	214,008	152,614	267,168

② 최근 3년 수출, 내수 비중

(단위 : 백만원)

구분	제46기 (2025년)	제45기 (2024년)	제44기 (2023년)	
반도체 장비 부문 (제품 및 부품매출)	수출	465,299	230,639	116,728
	내수	111,386	328,278	42,281
	합계	576,685	558,917	159,009

③ 최근 3년 지역, 제품별 매출 비중



*글로벌 시장 구조

현재 글로벌 TC 본더(Thermal Compression Bonder) 시장은 AI 반도체의 핵심인 HBM(고대역폭 메모리) 수요에 따라 급격히 팽창하고 있다. 이 시장은 과거 범용 장비 시장에서 현재는 한미반도체를 필두로 한 소수 정예의 과점 체제로 재편되었다. 2025년 기준 한미반도체가 71.2%로 압도적 점유율을 가지고 있다.

주요 제품 사진



TC 본더



micro SAW

02 기업 분석

한미반도체

글로벌 점유율 71%의 확산, 한미반도체 TC 본더

4) 주요 경쟁사별 분석

1. ASMP-T-글로벌 강자

한미반도체의 가장 강력한 글로벌 라이벌이다. 마이크론과 SK하이닉스 공급망 일부를 점유하고 있으며, 차세대 하이브리드 본딩 기술력에서 한미반도체와 선두 다툼을 벌이고 있다.

2. 한화세미텍

최근 SK하이닉스로부터 대규모 수주를 따내며 가장 위협적인 경쟁사로 부상했다. 2026년 초에도 한미반도체와 비슷한 규모의 HBM4용 장비 발주를 받는 등 SK하이닉스 내 점유율을 빠르게 높이고 있다.

3. 세메스 (SEMES)

삼성전자의 자회사로, 삼성전자의 HBM 장비 물량을 주로 책임진다. 최근 삼성전자와 하이브리드 본더(Hybrid Bonder) 공급 계약을 국내 최초로 맺으며, 차세대 HBM4 시장에서 한미반도체를 위협하는 기술적 성과를 냈다. 삼성전자의 초미세 공정에 최적화된 장비를 적기에 공급하여 삼성의 반도체 경쟁력을 뒷받침하는 '수직계열화' 전략을 쓴다.

5) 지배 구조

최대주주 및 주주 현황

한미반도체의 최대 주주는 광동신 회장으로, 33.56%를 직접 보유하고 있다. 최대주주와 특수관계인들의 지분을 합치면 약 55% 수준으로, 오너 중심의 안정적인 경영 지배력이 유지되고 있다. 주요 기관 투자자로는 7.67%를 보유하고 있는 미래에셋자산운용과 5.48%를 가진 국민연금공단이 있다.

한미반도체 계열구조

한미반도체는 글로벌 고객사(TSMC, 마이크론, 대만 OSAT 등)에 대한 밀착 서비스를 위해 주요 거점별로 법인을 운영 중이다. 2026년 기준 한미차이나, 한미베트남, 한미싱가포르, 한미타이완으로 4개의 계열사가 있다.

6) 최근 이슈

1. 2세대 하이브리드 본더' 연내 출시 발표

2026년 4월 9일, 한미반도체는 '2세대 하이브리드 본더' 시제품을 연내 출시하겠다고 공식 발표했다. 하이브리드 본딩은 칩을 범프(납땜) 없이 직접 붙이는 꿈의 기술이다. 내년 상반기 가동을 목표로 하이브리드 본더 전용 공장을 건설 중이다. 이는 삼성전자의 세메스나 네덜란드의 베시(Besi)와의 기술 전쟁에서 주도권을 뺏기지 않겠다는 강력한 의지이다.

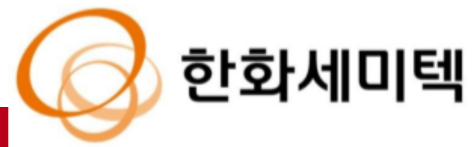
2. 마이크론과의 관계 강화

최근 한미반도체는 마이크론의 인도 반도체 공장 오픈식에 핵심 협력사로 초청받는 등 마이크론 내에서의 입지를 굳건히 하고 있다. 과거 SK하이닉스의 존도가 높았으나, 현재는 마이크론 매출 비중이 급격히 늘어나며 고객사 다변화에 성공했다.

주요 경쟁사



ASMP-T



한화세미텍



SEMES

03 투자포인트

한미반도체

글로벌 점유율 71%의 확신, 한미반도체 TC 본더

1) AI, HBM 산업 현황

① AI 반도체 성장 → HBM 수요 폭증 → TC 본더 구조적 성장

최근 AI 서버 및 데이터센터 투자가 급증하면서 고대역폭 메모리(HBM) 수요가 빠르게 증가하고 있다. HBM은 기존 DRAM 대비 적층 구조가 복잡하고, 칩 간 연결을 위해 TC 본딩(Thermal Compression Bonding) 공정이 필수적으로 사용된다. 이 과정에서 TC 본더 장비 수요는 HBM 생산량과 거의 동일한 방향으로 증가하는 구조를 가진다. 특히 주요 고객사인 SK하이닉스와 삼성전자가 HBM CAPEX를 공격적으로 확대하고 있어, 관련 장비 공급사인 한미반도체의 수혜가 직접적으로 발생하고 있다.

즉, "AI → HBM → TC 본더 → 한미반도체"로 이어지는 명확한 수요 전이 구조가 형성되어 있으며, 이는 단순 경기 사이클이 아닌 구조적 성장으로 판단된다.

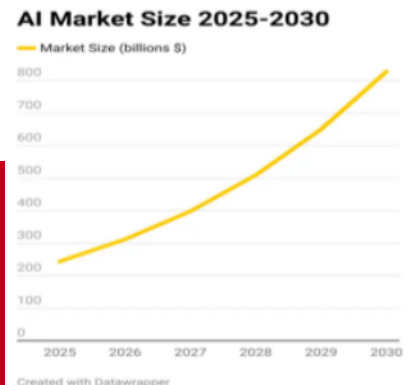
② AI 시장 성장 예측 (Cargoson.com)

2025 약 2440억 달러
2026 약 3120억 달러
2030 약 8270억 달러
연평균 성장률 약 30%

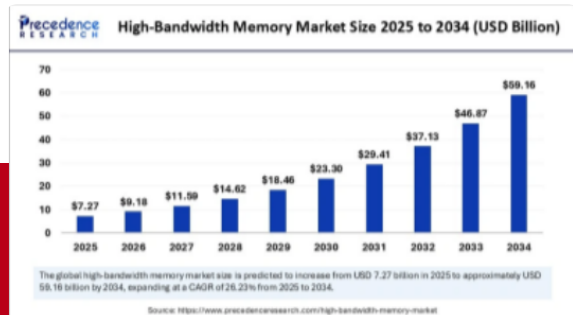
③ HBM 시장 성장 예측 (precedence research)

2025 72.7억 달러
2026 91.8억 달러
2034 591.6억 달러
연평균 성장률 약 26%

산업별 성장 동향



AI 산업 성장률



HBM 산업 성장률

03 투자포인트

한미반도체

글로벌 점유율 71%의 확신, 한미반도체 TC 본더

2) TC 본더 시장 내 과점 구조 및 높은 진입장벽

TC 본딩 장비는 고온·고압 환경에서 미세 칩을 정밀하게 접합하는 고난도 장비로, 높은 기술력과 공정 안정성이 요구된다. 특히 반도체 고객사의 생산라인에 장비가 적용되기 위해서는 장기간의 테스트와 수율 검증이 필요하기 때문에 신규 업체의 진입이 매우 제한적이다. 한미반도체는 글로벌 TC 본더 시장에서 선도적인 위치를 확보하고 있으며, 고객사 인증을 기반으로 강한 락인(lock-in) 효과를 보유하고 있다. 장비 특성상 기존 공급업체를 쉽게 교체하기 어렵기 때문에, 시장 내 과점 구조가 유지되는 특징이 있다.

결과적으로 TC 본더는 반도체 장비 중에서도 진입장벽과 고객 종속성이 매우 높은 영역으로, 안정적인 수주 기반을 확보할 수 있는 사업 구조를 가진다. 2025년 HBM용 TC 본더 시장 보고서에 따르면 한미반도체는 올해 3분기 누적 매출 2억 4770만 달러 (약 3660억원)를 기록했고 이는 TC 본더 글로벌 시장에서 71.2%의 점유율로 1위이다.

3) HBM 고단화에 따른 ASP 상승 및 수익성 개선

HBM은 세대가 발전할수록 적층 수 증가 및 미세화가 진행되며, 이에 따라 TC 본딩 공정의 난이도도 상승한다. (HBM3 → HBM3E → HBM4)

이로 인해 더 높은 정밀도와 성능을 요구하는 고사양 TC 본더 장비의 비중이 확대되고 있으며, 이는 장비 평균판매가격(ASP) 상승으로 이어진다.

또한 고부가가치 장비 비중 확대에 따른 제품 믹스 개선 효과가 발생하면서, 매출 성장뿐만 아니라 영업이익률 개선까지 동반되는 구조가 형성되고 있다.

즉, 단순한 물량 증가가 아니라 "ASP 상승 + 믹스 개선"이 동시에 발생하는 이익 레버리지 구간에 진입한 것으로 판단된다.

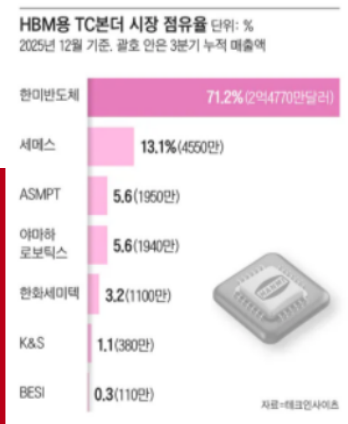
4) 고객사 HBM 투자 사이클 초기 국면

현재 글로벌 반도체 업체들의 HBM 관련 투자는 초기 확장 단계에 진입한 상황으로, 향후 2~3년간 증설이 본격화될 가능성이 높다.

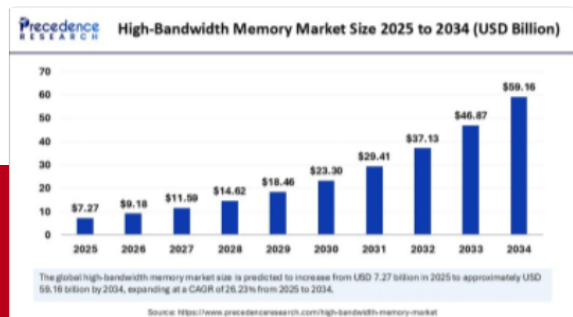
반도체 장비 업종 특성상 실적은 고객사의 투자보다 선행하여 반영되는 경향이 있기 때문에, 현재 시점은 실적 성장 초입 구간으로 해석할 수 있다.

특히 HBM은 AI 산업 확장과 직결된 핵심 부품으로, 기존 메모리 대비 구조적 성장성이 높은 영역이라는 점에서 중장기 성장 지속성이 높다. 실제로 삼성전자와 Sk 하이닉스 모두 투자 확대를 통해 HBM 생산 능력의 증가를 도모하고 있다. 삼성전자는 2026년까지 HBM 웨이퍼 생산량을 월 25만 장 수준으로 끌어올릴 계획이고, 이는 전년 대비 50% 커진 수치이다. 하이닉스 역시 용인 반도체 클러스터에 21조 6000억 원을 추가 투자하여 2027년에 완공하는 것을 목표로 한다.

산업별 성장 동향



TC본더 시장 점유율



HBM 산업 성장률

04 리스크

한미반도체

글로벌 점유율 71%의 확산, 한미반도체 TC 본더

1) 실적 전망 및 성장 둔화 리스크 (수치 중심)

현재 시장은 한미반도체가 2026년에 매출 8,000억 원 시대를 열 것으로 보고 있지만, 이는 AI 투자 사이클에 따른 변동성이 큼니다.

***리스크 해석: 2025년 매출은 사상 최대였으나 영업이익은 소폭 감소(1.6% ↓)했습니다. 2026년 가파른 성장이 예상되나, 영업이익률 50%라는 높은 기대치가 유지되지 못할 경우 주가 조정 리스크가 발생할 수 있습니다.**

2) 시장 독점력 약화 및 경쟁 리스크 (점유율)

한미반도체의 강력한 무기인 HBM TC 본더의 시장 점유율 데이터

현황: 테크인사이드(2025.12) 기준, 글로벌 HBM용 TC 본더 시장 점유율 71.2%로 압도적 1위.

***리스크 해석: 현재 70%가 넘는 독점적 지위는 역설적으로 '추가 점유율 확대의 어려움'을 의미합니다. 한화세미텍, ASMP 등 경쟁사의 진입으로 점유율이 60%대로 하락하기 시작할 때 시장의 우려가 커질 수 있습니다.**

3) 수출 비중 확대에 따른 대외 변수 리스크

2024년과 2025년 사이에 매출 구조가 급격히 변했습니다.

2024년: 내수 58.7% / 수출 41.3%

2025년: 내수 19.3% / 수출 80.7%

***리스크 해석: 국내(SK하이닉스 등) 비중이 줄고 해외 비중이 80%를 넘어섰습니다. 이는 환율 변동성과 미-중 무역 분쟁 등 글로벌 거시 경제 상황에 과거보다 훨씬 더 취약한 구조가 되었음을 시사합니다.**

3) 기술적 리스크: 하이브리드 본딩(Hybrid Bonding)

내용: 현재는 열과 압력을 가하는 TC 본딩 방식이 주류지만, 향후에는 범프(Bump) 없이 칩을 직접 붙이는 하이브리드 본딩이 도입될 예정입니다.

리스크 해석: 한미반도체는 2029년 양산을 목표로 차세대 하이브리드 본더를 개발 중이나, 만약 시장의 기술 전환 속도가 예상보다 빨라진다면 기존 TC 본더 매출이 타격을 입을 수 있습니다.

산업별 성장 동향

(단위 : 백만원)

구분		제46기 (2025년)	제45기 (2024년)	제44기 (2023년)
반도체 장비 부문 (제품 및 부품매출)	수출	465,299	230,639	116,728
	내수	111,386	328,278	42,281
	합계	576,685	558,917	159,009

	2025.01.01 ~ 2025.12.31	2024.01.01 ~ 2024.12.31	2023.01.01 ~ 2023.12.31
매출액	576,685	558,917	159,009
영업이익	251,390	255,392	34,571
법인세차감전순이익	278,383	198,374	345,280
당기순이익	214,008	152,614	267,168
· 지배기업 지분순이익	214,008	152,614	267,168

내수시장 약세로 전환

한미반도체 영업이익 1.6% 감소



(주)한미반도체

불패전사 한사위
한사WITH 1조

39기 방성민
40기 임소는 40기 이재준